

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月19日(19.10.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/199924 A1

(51) 国際特許分類:
H01B 1/22 (2006.01) *C08L 63/00* (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01) *H01B 1/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/014781

(22) 国際出願日: 2023年4月11日(11.04.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-067363 2022年4月15日(15.04.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド(**THREEBOND CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 遠藤 悟(**ENDO, Satoru**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 鈴木 崇史(**SUZUKI, Takashi**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: I B C 一番町弁理士法人(**IBC**); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: ELECTROCONDUCTIVE PASTE AND CURED PRODUCT

(54) 発明の名称: 導電性ペーストおよび硬化物

(57) Abstract: The present disclosure relates to an electroconductive paste containing components (A) through (C). Component (A) is an epoxy resin, component (B) is a latent curing agent, and component (C) is a plate-like crystalline metal powder having an average grain size of 0.6 to 1.4 μm . The present invention provides an electroconductive paste that is capable of producing a balance between the conductivity and the adhesive strength of the resulting cured product.

(57) 要約: 本開示は、下記の(A)～(C)成分を含む、導電性ペーストに関する。(A)成分: エポキシ樹脂 (B)成分: 潜在性硬化剤 (C)成分: 平均粒径0.6～1.4 μm であるプレート状の結晶性金属粉。本発明によれば、得られる硬化物の導通性と接着力とを両立することができる導電性ペーストが提供される。



WO 2023/199924 A1